

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年5月31日(2022.5.31)

【公開番号】特開2021-177561(P2021-177561A)

【公開日】令和3年11月11日(2021.11.11)

【年通号数】公開・登録公報2021-055

【出願番号】特願2021-111563(P2021-111563)

【国際特許分類】

H 01 L 23/36(2006.01)

10

H 01 L 23/373(2006.01)

H 05 K 9/00(2006.01)

H 05 K 7/20(2006.01)

B 32 B 7/025(2019.01)

B 32 B 7/027(2019.01)

B 32 B 27/00(2006.01)

【F I】

H 01 L 23/36 D

20

H 01 L 23/36 M

H 05 K 9/00 U

H 05 K 7/20 F

B 32 B 7/025

B 32 B 7/027

B 32 B 27/00 B

【手続補正書】

【提出日】令和4年5月23日(2022.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

30

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の熱伝導性樹脂層と、導電層と、第2の熱伝導性樹脂層とをこの順に備え、

前記第1の熱伝導性樹脂層及び前記第2の熱伝導性樹脂層が、それぞれ、シリコーン樹脂及び熱伝導性フィラーを含み、

前記熱伝導性フィラーは、粒度分布において、粒径10μm以上100μm以下の範囲に極大値を有する熱伝導性フィラー(B-1)と、粒径1μm以上10μm未満の範囲に極大値を有する熱伝導性フィラー(B-2)と、粒径1μm未満の範囲に極大値を有する熱伝導性フィラー(B-3)と、を含む、

電磁波シールド性放熱シート。

40

【請求項2】

前記第1の熱伝導性樹脂層及び前記第2の熱伝導性樹脂層の厚さが、それぞれ、3mm以上である、請求項1に記載の電磁波シールド性放熱シート。

【請求項3】

前記第1の熱伝導性樹脂層及び前記第2の熱伝導性樹脂層の少なくとも一方に複数の切り込みが形成されている、請求項1又は2に記載の電磁波シールド性放熱シート。

【請求項4】

電子部品と、

50

請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の電磁波シールド性放熱シートと、
前記電子部品及び前記電磁波シールド性放熱シートを収容する筐体と、を備え、
前記電磁波シールド性放熱シートは、前記第 1 の熱伝導性樹脂層が前記電子部品に接触し
、前記第 2 の熱伝導性樹脂層が前記筐体に接触するように配置されている、電子機器。

10

20

30

40

50